Contribution ID: 286 Type: Oral report

40GHz TES 探测器的仿真优化与加工

Wednesday, 14 August 2024 15:15 (15 minutes)

宇宙微波背景辐射(CMB)是宇宙大爆炸后早期冷却过程产生的遗留辐射,保留了丰富的宇宙早期信 息。目前 CMB 实验的主要观测目标已经变为极其微弱的 B 模式极化,在大尺度上测量 CMB 的 B 模式 偏振是探测在暴涨时期产生的张量扰动(原初引力波)的最主要方式。这需要在观测中使用极低噪声 等效功率的探测器。超导转变边沿探测器(Transition Edge Sensor,TES)是以超导薄膜作为温度计的一 种热平衡探测器,具有极低的噪声和极高的灵敏度,是当前主流的 CMB 望远镜探测器。TES 探测器可 探测低频、中频和高频的 CMB 信号,低频范围的探测主要是在 40GHz 附近观测。通过 TES 探测器来 探测 CMB 的 B 模式极化, 微波信号被耦合到电路当中, 通过平面正交模耦合器、共面波导、微带线、 滤波器、交叉器等微波链路结构,进行频率选通后传输到 TES 探测器。因此需要首先对前端微波器件 进行仿真设计,通过修改微波器件的结构尺寸以及优化材料可以对其性能进行优化。我们选用了低损 耗的富硅衬底重新开展了 40GHz TES 探测器前端微波链路的设计,对平面正交模耦合器、共面波导转 微带线的阻抗匹配段、滤波器以及交叉器结构的仿真设计与计算,通过仿真优化,在 30GHz 50GHz 范 围内, 微波信号最小透过率在 88% 以上。通过微纳加工手段来进行 TES 探测器芯片的加工, 芯片结构 是按层生长的。我们选用定制的已长有低应力 SiNx 的硅片作为起始硅片,整个工艺流程包括 9 次光 刻、5次干法刻蚀、1次湿法刻蚀、3次剥离、3次磁控溅射和4次电子束蒸发。我们测量了最后整体的 加工误差大约有 1um 的偏移,但由于提前预留的余量充足,所以 1um 的偏移不影响 TES 的性能。加 工的重难点主要在于 Nb 的高选择比刻蚀、氮化硅及 AlMn 的生长, 工艺的均匀性以及稳定性, 以及最 后一步的深硅刻蚀。目前采用了新的 Nb 线层刻蚀配方,在保证高刻蚀选择比的前提下,降低刻蚀侧 壁的垂直度,使薄层金属更容易搭接,目前的工艺已经可以保证有比较高的成功率。现在在做的新一 版 TES 加工,等最后一步深硅工艺摸索出来以后有望得到完整的符合要求的 TES 单像素芯片,进而可 以对 TES 整体进行光学测试,为后续 TES 阵列的加工提供保证。

Primary author: 袁, 双双

Presenter: 袁, 双双

Session Classification: 分会场五

Track Classification: 粒子物理实验技术